

证券代码：301095

证券简称：广立微

# 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者网上提问
时间	2026年4月29日（周三）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 郑勇军 2、董事会秘书、财务总监 陆春龙 3、独立董事 朱茶芬
交流内容及具体问答记录	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、海外大数据类产品实现落地突破，目前落地场景和客户反馈如何，后续海外拓展重点方向？</b></p> <p>尊敬的投资者您好！2025年公司大数据软件首次实现海外销售突破，主要服务于晶圆制造厂的良率管理与缺陷分析，获得海外客户积极反馈，标志着公司大数据软件具备较强的国际竞争力。后续海外拓展的重点方向是树立公司品牌、加强客户认可，通过海外市场持续打磨产品与技术，为全球化布局奠定坚实基础。感谢您的关注！</p> <p><b>2、去年设备类、软件类收入增长节奏有差异，后续业务结构会如何调整优化？</b></p>

尊敬的投资者您好！2025 年，公司软件与硬件收入增长节奏有所差异：软件开发及授权同比增长 75.13%，测试设备及配件同比增长 17.30%，软件业务快速增长，主要得益于先进制程扩产带来的良率提升需求增长，以及 DFT、DFM、大数据软件等新品类软件加速商业化落地。后续公司将践行“软硬协同、光电并行”业务发展策略：软件端，持续丰富 DFT/DFM 工具链，推动大数据软件海内外市场同步发力，加速 PDA 产品商业化；硬件端，巩固 WAT 设备龙头地位，拓宽老化测试、WLR、硅光测试等设备品类。中长期目标是实现软硬件均衡发展，提升软件等高毛利业务占比，增强整体盈利能力和抗风险能力。感谢您的关注！

**3、海外业务去年增速亮眼，增长主要来自哪些区域，下游客户主要是什么类型？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司境外收入 2,208.42 万元，同比增长 78.66%，主要是通过股权并购将比利时 LUCEDA NV 的财务报表纳入合并范围，LUCEDA NV 在全球硅光 PDA 领域拥有成熟的业务体系，使公司客户群体快速扩大至欧美市场，下游客户包括 Foundry、Fabless 和 IDM 等各种类型。依托国内客户资源与海外渠道双向协同，公司正加速建设具有世界影响力的平台型 EDA 企业。感谢您的关注！

**4、公司硅光芯片检测设备现状什么进展了？有没有具体的时间进度**

尊敬的投资者您好！公司高度关注硅光芯片检测领域的技术布局与市场机遇。2025 年，公司完成了对全球硅光设计自动化领军企业 LUCEDA NV 的收购，并宣布与浙江大学共建“硅光技术及量测装备联合研发中心”，将晶圆级硅光测试设备及良率提升方案作为重点攻关方向。目前相关研发工作正按计划有序推进，公司依托在电性测试设备领域十多年的技术积累，与 LUCEDA 在光学设计上的优势形成互补，致力于构建覆盖硅光芯片设计、制造、测试的完整解决方案。后续进展及具体时间节

点，公司将严格按照信息披露要求，通过公告或定期报告及时向投资者披露。感谢您的关注！

**5、结合 2025 年经营情况，公司本次分红方案是如何考量的，中长期分红政策是否会保持稳定？**

尊敬的投资者您好！2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发约 3,941 万元。截至 2025 年末，母公司未分配利润为 1.14 亿元，合并报表未分配利润为 2.59 亿元，本次分红金额占上述指标孰低值的 34.53%，在保障公司充足资金储备的同时，有效兼顾了对投资者的即期回报。公司已制定完善的《上市后三年股东分红回报规划》，未来将持续统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制。该方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。感谢您的关注！

**6、结合 2025 年经营基数，2026 年公司在营收、盈利、海外拓展等方面有没有初步经营规划？**

尊敬的投资者您好！2026 年，公司将围绕六大方向持续发力：第一，公司将继续推进 AI 与大模型在全产品线上的深度融合，筑牢研发与产品的核心竞争力，构建面向未来的智能化技术底座。第二，紧抓先进制程扩产机遇。公司将持续深耕晶圆厂全流程良率解决方案，助力客户先进制程产能高效爬坡，进一步巩固在先进工艺项目中的市场优势。第三，打通制造到设计全链路。公司会把多年积累的制造端经验深度赋能芯片全生命周期，实现从制造到设计的协同优化，为客户提供闭环的解决方案。第四，加码硅光全产业链布局。依托 LUCEDA 的技术积淀与广立微的市场优势，公司将逐步覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升全环节，打造系统性解决方案，打开长期成长空间。第五，测试设备巩固龙头地位。公司将持续加大研发投入，持续扩大在优势领域的市场份额；同时积极拓展硅光等新场景的测试能力，为新兴赛道提供配套测试支撑。最后，公司将加速海外市场渠道建设与品牌推广，提升国际市场份额。感谢您的关注！

**7、硅光业务目前处于发展什么阶段，未来一到两年，对公司营收和业绩的贡献预期如何？**

尊敬的投资者您好！目前公司硅光业务尚处于战略布局与技术整合的早期阶段。2025年，公司通过并购全球硅光 PDA 领军企业 LUCEDA 正式切入该赛道，但并表仅覆盖 8 月至 12 月不足 5 个月，对整体营收贡献较小。同年 LUCEDA 发布了业界首款硅光异质异构集成 PDK，并与广立微合作推出了 DE-Photonics 和 Photonics DRC 工具，整合进展高效。展望 2026 至 2027 年，公司计划加大投入，并与浙江大学共建联合研发中心，致力于构建覆盖设计、测试与良率提升的完整解决方案。伴随 AI 算力需求驱动，硅光芯片市场正迎来爆发期，技术储备将成为公司中长期新的增长曲线。感谢您的关注！

**8、去年各项期间费用有所增加，费用主要投入在哪些板块，后续是否会优化费用管控节奏？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司期间费用主要投入以下板块：（1）研发费用：全年投入 3.03 亿元，同比增长 9.48%，占营收 41.19%。资金主要投向 DFT/DFM 工具开发、大数据平台 AI 化升级、测试设备品类拓展及硅光 PDA 技术研发，研发人员增至 672 人。（2）管理费用：同比增长 49.95%，主要因公司规模扩大及总部大楼投入使用，折旧摊销与办公费用增加。（3）销售费用：同比增长 15.13%，用于加大市场推广力度及海外渠道建设。后续公司将通过 AI 赋能内部运营、优化管理流程等方式提升费用效率，在保障核心研发投入的同时，控制管理费用增速，实现降本增效与可持续发展的平衡。感谢您的关注！

**9、2025 年下游晶圆厂资本开支回暖，公司客户集中度有无变化，核心客户合作是否持续深化？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司前五大客户销售占比为 72.37%，这主要与公司以晶圆厂为主要客户群体的业务结构有关。随着下游资本开支增加，公司与主要客户的合作持续深化。但下游晶圆制造行业本身集中度较高，即使资本开支回暖，大客

户贡献高占比仍将是行业常态。为从根源上优化客户结构，公司正积极推进多元化产品布局。随着 DFT 软件、大数据产品及 PDA 软件加速商业化，以及硅光全生命周期解决方案的推出，公司客群将从晶圆厂大幅扩展至芯片设计公司、封测厂等，可触达客户数量显著提升，有望在保持存量优势的同时逐步降低客户集中度。感谢您的关注！

**10、在 25 年营收增长的情况下，扣非净利润却下降，26 年公司有无提升公司利润的相关措施**

尊敬的投资者您好！2025 年公司营收同比增长 34.40%，但扣非归母净利润同比下降 25.30%，核心原因有三：一是自 2025 年下半年以来，公司订单快速增长，受客户验收节点的季节性影响，三、四季度的验收确认量较大，导致 2025 年末的应收账款余额较大，根据公司坏账准备计提政策计提约 2000 万元坏账准备。二是根据各纳税主体的利润情况和税收政策确认的所得税费用增加所致。三是高研发投入与刚性成本上升。公司持续加大研发投入，并因业务规模扩大及总部大楼投用导致管理费用等刚性运营成本增加。上述因素均为阶段性影响，随着期后回款逐步到位、研发成果商业化落地，利润水平有望逐步改善。

2026 年公司将从五方面提升利润：第一，坚持技术创新，强化核心竞争力与技术壁垒，依托高附加值产品及综合解决方案，稳定经营收益。第二，优化收入结构，加大高毛利软件业务拓展力度，提升软件收入占比，稳步改善综合毛利率。第三，深化内部管控，以 AI 赋能研发与运营管理，全面降本增效，提升整体运营效率。第四，完善应收账款全流程管理，强化客户信用管控与回款跟踪，加快资金回笼，降低减值风险。第五，合理统筹资金调度与配置，提升资金使用效率与理财收益，持续增厚公司利润水平。感谢您的关注！

**11、AI 相关良率分析工具已落地应用，目前商业化落地情况、客户覆盖及实际使用效果怎么样？**

尊敬的投资者您好！公司 AI 相关良率分析工具已实现规模

化商业落地，取得显著成效。大数据分析软件方面，已形成“INF-AI 机器学习平台+SemiMind 大模型平台”格局，INF-AI 旗下 INF-ADC 自动缺陷分类系统客户数量显著提升，INF-WPA 晶圆缺陷图案分析及 iCASE 缺陷异常诊断系统等已在客户处部署使用；SemiMind 大模型平台落地设计、测试、良率分析等多类专业智能体。EDA 软件方面，公司的 DFT 工具集中的良率分析工具 QuanTest-YAD 已深度融合 AI 算法，并在行业头部晶圆厂（Fab）完成双重认证。感谢您的关注！

**12、公司测试设备、EDA 软件的订单交付周期大概多久，现阶段在手订单储备是否充足？**

尊敬的投资者您好！关于订单交付周期，测试设备方面，在客户明确交货需求后，从组装测试机、嵌入控制软件、调试验证到现场安装调试，整套流程约需 2-3 个月，叠加前端备货排产与后端验收流程，从收到正式订单到完成验收的整体周期可能延长至 4-6 个月；EDA 软件交付节奏更快，软件产品授权在客户发出交货通知后几日内即可完成交付。

关于在手订单，2025 年年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 649,201,074.79 元，较 2024 年年末金额同比增长 51.16%。综合来看，公司在手订单储备较为充足，测试设备与软件业务增长均具备较好的订单支撑。感谢您的关注！

**13、公司 2025 年经营现金流表现一般，主要是客户回款周期拉长，还是内部投入增加带来的影响？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司经营活动现金流量净额为 -1.22 亿元，与净利润出现阶段性背离，核心原因既涉及内部投入增加，也与客户回款节奏密切相关。

（1）从经营活动现金流出来看，一方面，随着公司测试设备业务的增长，本期加大了设备部件的采购力度，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加 166,801,157.56 元，增长 102.27%；另一方面，随着公司规模进一步扩大，本期付现费用

较上年同期亦有所增加。（2）从经营活动现金流入来看，公司业务呈现明显的季节性波动特征，3-4 季度的含税收入在 5 亿元以上，该部分货款未能及时完成回款，导致销售回款未能同步增长。综合前述因素影响，导致本期经营活动产生的现金流量净额出现负值。

总体来看，这属于订单扩张期的正常营运资金占用，而 2026 年一季度公司经营现金流已实现由负转正，货款正陆续收回，现金流状况明显改善。感谢您的关注！

**14、站在中长期角度，未来 1-2 年，哪块业务会成为公司核心增长动力？**

尊敬的投资者您好！展望未来 1-2 年，软硬件业务将共同构成公司的核心增长动力。软件方面，DFT 和 DFM 等新品类 EDA 工具正加速商业化落地，大数据软件海内外市场同步发力，叠加并购 LUCEDA 切入硅光 PDA 赛道，软件业务增速有望延续高增长态势。硬件方面，测试设备全年销售 109 台，同比增长 21.11%，在手订单大幅增加；同时晶圆级老化设备、WLR 可靠性设备及高压测试机等新品相继推出，进一步丰富了产品矩阵。公司将持续做好研发部署与运营规划，努力实现软硬件双轮驱动与“电+光”双赛道并行的多维增长格局。感谢您的关注！

**15、2025 年整体毛利率有所回落，想了解下滑主要是产品结构、市场竞争还是成本上涨导致？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司整体毛利率为 57.78%，同比下降 4.12 个百分点，回落的核心原因在于产品内部成本结构的变化所致。分业务看：软件开发及授权毛利率同比下降 16.01 个百分点至 69.95%，主要因为 2025 年度公司的总包服务承接能力快速提升，但部分后端设计服务需要与其他合作方共同完成，外协成本的增加导致软件业务毛利率下降，这是业务规模扩大下的主动战略选择，随着公司综合服务能力的进一步提升，外部协作成本将有效降低，软件毛利率有望企稳回升；测试设备及配件毛利率 50.42%，基本保持稳定。展望后续，随着公司整体技术

能力的增强，以及硬件关键部件国产化替代持续推进，毛利率有望逐步改善，长期软件收入占比提升也将带动综合毛利率结构性回升。感谢您的关注！

**16、公司 EDA 工具目前覆盖哪些产业链环节，高端工具研发和商业化落地的推进计划是什么？**

尊敬的投资者您好！公司自动化设计工具已形成五大产品矩阵：可测试性设计 EDA（DFT），覆盖扫描测试、ATPG、MBIST 等全流程；可制造性设计 EDA（DFM），具备覆盖设计版图、图形分析、制造工艺分析的全链路闭环优化能力；良率提升 EDA，贯穿工艺开发至量产监控全生命周期；大数据分析平台，覆盖离线与在线分析，深度融入 AI 与 LLM 大模型；光子设计工具（PDA），通过并购 LUCEDA 切入硅光赛道，提供光电子集成芯片设计、仿真、PDK 搭建及运维的全流程软件和服务。在高端工具研发与商业化落地方面，公司将以 AI 技术全链路赋能为核心，加速 DFT 全流程平台及 DFM 系列工具的市场推广；打通制造端经验到设计端的闭环，为客户提供一站式良率解决方案；同时联合 LUCEDA 加速覆盖硅光芯片设计、制造、测试全环节的 PDA 工具协同开发与商业化，拓展新兴赛道增长空间。感谢您的关注！

**17、自研测试设备国产替代进程持续推进，对比海外头部企业，现阶段技术差距和追赶节奏如何？**

尊敬的投资者您好，公司 WAT 测试设备打破海外长期垄断，掌握了晶圆级电性测试设备并行测试技术、片内测试加速方法等业界领先的关键核心技术，技术水平全球领先，实现了高质量的国产替代，目前公司 WAT 测试设备已在多个主流晶圆厂量产线平稳运行多年，技术实力得到实践认可。品类上，公司先后推出优化升级的 WAT 测试设备（T4000 机型、T4000 Max 机型、高压测试机）、晶圆级可靠性测试、晶圆级老化测试设备等，不断扩大产品矩阵，丰富应用场景，为后续的长足发展蓄能。感谢您的关注！

**18、四季度单季盈利表现偏弱，请问季度利润承压的短期因素有哪些？**

尊敬的投资者您好！2025年第四季度公司实现营收3.07亿元，同比增长18.39%，归母净利润5,167万元，同比下降28.79%，主要原因系：一是2025年10月公司完成总部大楼搬迁，叠加原租赁场地退租、大楼资产折旧摊销等因素导致整体搬迁费用增加；二是信用减值损失集中计提，受客户验收季节性影响，三、四季度验收确认量较大，期末应收账款余额高企，四季度确认了较大金额的坏账准备。上述因素综合影响导致四季度利润增速阶段性承压。随着期后回款逐步到位，上述影响有望减弱。感谢您的关注！

**19、2025年公司营收实现稳步增长，但净利润增速明显偏低，增收不增利的核心原因是什么？**

尊敬的投资者您好！2025年公司营收同比增长34.40%，归母净利润同比增长10.49%，利润总额同比增幅超50%。净利润增速偏低的核心原因有三：一是自2025年下半年以来，公司订单快速增长，受客户验收节点的季节性影响，三、四季度的验收确认量较大，导致2025年末的应收账款余额较大，根据公司坏账准备计提政策计提约2000万元坏账准备。二是根据各纳税主体的利润情况和税收政策确认的所得税费用增加所致。三是高研发投入与刚性成本上升。公司持续加大研发投入，并因业务规模扩大及总部大楼投用导致管理费用等刚性运营成本增加。上述因素均为阶段性影响，随着期后回款逐步到位、研发成果商业化落地，利润水平有望逐步改善。感谢您的关注！

**20、当前国产半导体工具替代持续推进，下游客户对公司产品认可度提升情况及行业竞争压力如何？**

尊敬的投资者您好！在国产替代持续推进下，下游客户对公司产品认可度显著提升。公司良率方案在国内新增先进工艺项目中市占率领先，成功拓展存算一体、Fabless等新客户群；大数据软件首次实现海外销售突破；DFT工具、DFM工具达到行业

领先水平并获头部客户订单。行业竞争方面，公司拥有软硬结合的差异化能力，经过多年布局，公司已形成 DFT、DFM、大数据分析等 EDA 软件与 WAT 测试设备高度协同的业务闭环，软件与硬件相互赋能、同步增长；叠加并购 LUCEDA 切入硅光 PDA 赛道，补齐光电子设计能力，进一步构筑了有别于传统 EDA 厂商的技术壁垒。公司将持续强化这上述优势，巩固市场地位。感谢您的关注！

**21、现阶段公司经营发展过程中，面临的主要经营和行业风险集中在哪些方面？**

尊敬的投资者您好！现阶段公司面临的主要风险及应对措施如下：（1）技术开发风险：EDA、PDA 及半导体测试技术迭代迅速，存在产品被赶超的风险。公司将时刻关注行业需求变化，与下游客户深度合作，持续完善技术创新体系。（2）行业波动风险：集成电路产业具有周期性，政策与贸易环境变化可能影响下游需求。公司将高度关注行业动态，做好市场需求预判，增强应对系统性风险的能力。（3）客户集中度风险：2025 年前五大客户销售占比达 72.37%。公司将通过完善产品矩阵、丰富客户群体类型、加大新市场开拓力度，逐步优化客户结构。（4）规模扩张风险：人员与业务快速扩张对管理能力提出更高要求。公司将不断完善内控体系，持续提高企业管理水平与运营效率。（5）贸易环境风险：国际贸易摩擦可能带来不确定性。公司将加强形势研判，积极开拓多元客户与销售区域，降低单一市场依赖。感谢您的关注！

**22、不同产品线之间毛利率存在差异，2025 年各业务毛利表现及后续变化趋势怎么看？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司各业务线毛利表现分化：软件开发及授权实现收入 2.78 亿元(+75.13%)，毛利率 69.95%，同比下降 16.01 个百分点，主要系 2025 年度公司的总包服务承接能力快速提升，但部分后端设计服务需要与其他合作方共同完成，外协成本的增加导致软件业务毛利率下降；测试设备及配件

实现收入 4.53 亿元 (+17.30%)，毛利率 50.42%，同比下降 1.65 个百分点，基本保持稳定。展望后续，随着公司综合服务能力的进一步提升，外部协作成本将有效降低，软件毛利率有望企稳回升；同时，硬件关键部件国产化替代持续推进，有助于设备毛利率逐步改善。长期看，随着软件业务占比持续提升，公司综合毛利率有望呈现结构性改善趋势。感谢您的关注！

**23、结合 2025 年行业整体走势，如何看待 2026 年半导体测试、EDA 行业的整体景气度？**

尊敬的投资者您好！展望 2026 年，半导体测试与 EDA 行业景气度有望持续上行。一方面，AI、高性能计算等应用驱动先进制程产能持续扩张，对高端 WAT 测试设备、良率提升 EDA 软件的需求将进一步放量。另一方面，工艺复杂度提升与车规级芯片对缺陷零容忍的要求，使得贯穿设计、制造、测试的全流程良率管理方案成为刚需，带动 DFT、DFM 及大数据分析系统等产品需求。2026 年，公司将深化 AI 与全产品线融合，紧抓先进制程扩产机遇，加速“电+光”双轮驱动战略落地，感谢您的关注！

**24、在 25 年营收增长 34.40 的情况下，扣非净利润下降 25，主要是什么原因导致？26 年有无提升公司利润的相关措施**

尊敬的投资者您好！2025 年利润增速低于营业收入，主因是研发投入持续高位运行（3.03 亿元）、年末应收账款大幅增加导致坏账计提增多，以及所得税费用同比增加。后续公司将通过提高高毛利软件业务占比、以 AI 赋能降本增效、加快货款催收等措施改善盈利质量，力争以更好的业绩回报股东。感谢您的关注！

**25、想问以下几个问题：**

1、贵司增收不增利润，是因为不注重利润的吗？如果重视，后续公司如何规划，今年 Q2 之后利润会得到改善吗？

2、贵司最新的在手订单情况是多少？

3、贵司市值管理如何执行，管理层对股价和市值有关关注吗？目前觉得是低估还是正常估值。

尊敬的投资者您好！（1）增收不增利情况：公司始终重视利润与股东回报。2025 年利润增速低于营业收入，主因是研发投入持续高位运行（3.03 亿元）、年末应收账款大幅增加导致坏账计提增多，以及所得税费用同比增加。后续公司将通过提高高毛利软件业务占比、以 AI 赋能降本增效、加快货款催收等措施改善盈利质量，力争以更好的业绩回报股东。（2）在手订单：2025 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 649,201,074.79 元。（3）市值管理：公司高度重视市值管理，已制定《市值管理制度》。管理层始终关注股价与市值表现，认为短期股价受多重因素影响，公司将通过持续创新、提升经营业绩、合理分红及加强投资者交流等方式，推动公司内在价值与市场价值的共同成长。感谢您的关注！

**26、全年扣非业绩波动较大，非经常性损益主要包含哪些内容，如何看待公司主业真实盈利水平？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司归母净利润为 8,868.80 万元，扣非净利润为 4,363.98 万元，非经常性损益合计 4,504.82 万元，主要包括两类：一是计入当期损益的政府补助 2,885.52 万元；二是金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益 2,614.65 万元，主要为公司现金管理取得的投资收益。扣非利润有所下降，主要受研发投入高增、应收账款减值计提及所得税费用增加等阶段性因素影响。公司主业增长态势良好，全年营收首破 1 亿美元大关，其中软件开发及授权业务同比增长 75.13%，测试设备销量首次突破 100 台，在手订单持续增加，真实盈利基础进一步夯实。感谢您的关注！

**27、公司 EDA 软件、测试设备、良率服务三大业务，2025 年各自增长情况和收入占比变化如何？**

尊敬的投资者您好！2025 年公司主要业务增长情况如下：  
（1）软件开发及授权：实现收入 2.78 亿元，同比增长 75.13%，占营收比重由上年的 29.04%提升至 37.84%。（2）测试设备及配件：实现收入 4.53 亿元，同比增长 17.30%，占营收比重由上

年的 70.66% 下降至 61.68%。整体来看，软件业务高速增长带动收入结构持续优化，软硬件协同发展的格局进一步巩固。感谢您的关注！

**28、领导，您好！我来自四川大决策**

**请问，DFT 和 DFM 工具的商业化进展如何？目前已进入哪些客户的供应链？收入规模和毛利率如何？**

尊敬的投资者您好！公司 DFT 和 DFM 工具商业化进展顺利。DFT 方面，Quantest 系列已完成架构全面升级，自研的良率感知诊断分析平台 YAD 达到行业领先水平，并成功斩获头部晶圆厂订单，DFT 设计服务收入实现快速增长。DFM 方面，产品系列已初具规模，具备覆盖设计版图、图形分析、制造工艺分析的全链路闭环能力，CMPEXP 等核心工具已在多家头部企业试用验证并获认可。相关收入归入“软件开发及授权”业务板块，2025 年度该板块整体收入增长 75.13%，随着软件业务规模效应显现，有望持续提升公司综合盈利水平。感谢您的关注！

**29、去年研发团队规模有无扩张，核心技术人员稳定性如何，是否会持续引进高端技术人才？**

尊敬的投资者您好！2025 年，公司研发团队持续扩充，研发人员从年初的 522 人增至年末的 672 人，占员工总数 81.36%，同比增长 28.74%；其中博士 27 人、硕士 410 人，30-40 岁骨干力量增长 122.12%，整体学历结构与梯队配置进一步优化。核心技术人员稳定，通过并购，LUCEDA 由光电子专家和 ICT 专家组成的核心团队整体融入，进一步扩展了硅光领域的研发实力。未来将持续引进高端技术人才，进一步夯实公司核心竞争力。感谢您的关注！

**30、前期并购的硅光相关企业，2025 年业绩贡献与业务整合进展整体是否符合预期？**

尊敬的投资者您好！公司 2025 年 8 月完成对全球硅光 PDA 领军企业 LUCEDA NV 的收购，并于 8 月 12 日起将其纳入合并报表范围。整体来看，该并购符合公司预期：短期业绩贡献有限，

但长期战略卡位与技术整合价值正加速兑现。由于硅光行业尚处发展早期，且并表仅覆盖不足 5 个月，LUCEDA 当期财务贡献较小，与收购公告中的风险提示一致。业务整合方面，协同开发快速推进，成效显著：LUCEDA 发布了业界首个硅光异质异构集成 PDK，并与公司合作开发的 DE-Photonics、Photonics DRC 工具已成功面市；同时，公司联合浙江大学与 LUCEDA 共建硅光技术研发中心，加速从“电”到“光”的战略拓展。感谢您的关注！

**31、新一年度，公司在产品迭代、客户开拓、交付能力建设上，核心落地举措有哪些？**

尊敬的投资者您好！2026 年公司核心落地举措主要围绕以下三方面：产品迭代上，深化 AI 与全产品线融合，夯实智能化技术底座；打通制造到设计全链路，持续完善良率提升闭环方案；加速硅光产业链布局，推动 LUCEDA 协同开发的 PDA 工具落地。客户开拓上，紧抓先进制程扩产与国产替代机遇，在深耕晶圆厂全流程良率方案的同时，积极向设计类与封测类企业拓展，构建多元化客户矩阵，并加速海外市场布局。交付能力建设上，持续提升员工专业素质，强化软件服务交付质量；同时扩大测试设备产能与产品品类，强化供应链韧性，保障高效高质量交付。感谢您的关注！

**32、全球技术贸易环境多变，相关政策限制对公司供应链、产品出口、业务拓展有无实质影响？**

尊敬的投资者您好！当前复杂的全球贸易环境对公司影响有限，总体风险可控。（1）供应链端：核心技术均为自主研发，关键部件已实现国产替代，无实质断供风险。（2）产品出口端：2025 年度公司境外营收仅占 3%，贸易限制对整体经营影响甚微。

（3）业务拓展端：一方面，外部限制加速了国内客户国产化需求，为公司良率提升软硬件业务带来新增量；另一方面，公司正积极开拓不同区域市场，多元化收入来源，以降低单一市场波动带来的潜在影响。感谢您的关注！

**33、2025 年研发投入保持高位，资金主要聚焦哪些技术研发方**

	<p><b>向，重点攻关领域是什么？</b></p> <p>尊敬的投资者您好！2025年公司研发投入达3.03亿元，占营业收入的41.19%，资金主要聚焦四大方向：（1）拓展EDA工具链：重点攻关可测性设计（DFT）与可制造性设计（DFM），推出行业领先的DFT平台Quantest及CMP仿真建模等全流程工具。（2）深化AI与大数据融合：打造半导体大模型平台SemiMind和INF-AI智能平台，新推出智能根因溯源QuickRoot、在线智能量测iMetrology等AI工具集，推动产品智能化升级。（3）丰富测试设备品类：研发200pin大通道WAT测试机及高压测试机，并推出面向第三代半导体的晶圆级老化测试设备，将测试能力扩展至第三代半导体领域。（4）布局硅光前沿赛道：通过并购LUCEDA，协同开发DE-Photonics及Photonics DRC等PDA工具，攻克硅光芯片设计、仿真与良率提升关键技术，开启“电+光”双轮驱动。感谢您的关注！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2026年4月29日